



2025年11月11日

各 位

キャリア付極薄銅箔「MicroThin™」フレキシブル基板用途に展開 ～ 高密度実装に伴う薄型化やファインピッチ化に対応 ～

当社(社長 納 武士)は、上尾事業所およびマレーシア工場(Mitsui Copper Foil (Malaysia)SDN.BHD.)にて製造しているキャリア付極薄銅箔のフレキシブル基板用途での新たな採用が始まりましたことをお知らせいたします。

当社のキャリア付極薄銅箔「MicroThin™」は、微細回路形成に適した $1.5\mu\text{m}$ ～ $5\mu\text{m}$ の銅箔厚みと複数種類の微細な粗化処理を組み合わせた製品であり、主に半導体パッケージ基板、スマートフォン用マザーボード(HDIプリント基板)に使用されています。

モバイル機器などの高性能化が進む中、従来は屈曲性が重視されていたフレキシブル基板においても、高密度実装に伴う薄型化やファインピッチ化が急速に進み、極薄銅箔へのニーズが高まっています。

当社「MicroThin™」は、従来リジッド基板向けに培ってきた極薄・高密着技術を活かし、フレキシブル基板においても微細回路形成や信頼性向上の要求に応えることができる材料として高い評価を得ており、既存設備で生産された「MicroThin™」が既に複数の顧客で量産採用が進み、用途拡大の動きが顕著になっています。

今後さらに進む高密度実装や高速通信対応への要求に向け、当社は様々な種類の樹脂に対応する「高温対応 MicroThin™」の開発を進めています。市場の変化を先取りし、早期の上市を目指すことで、電子材料分野における競争優位性を一層高めてまいります。

当社は、パーパスである「探索精神と多様な技術の融合で、地球を笑顔にする。」を基軸に、2030年のありたい姿である全社ビジョン「マテリアルの知恵で“未来”に貢献する、事業創発カンパニー。」を実現することで、サステナブル(持続可能)な社会作りに貢献します。

以 上

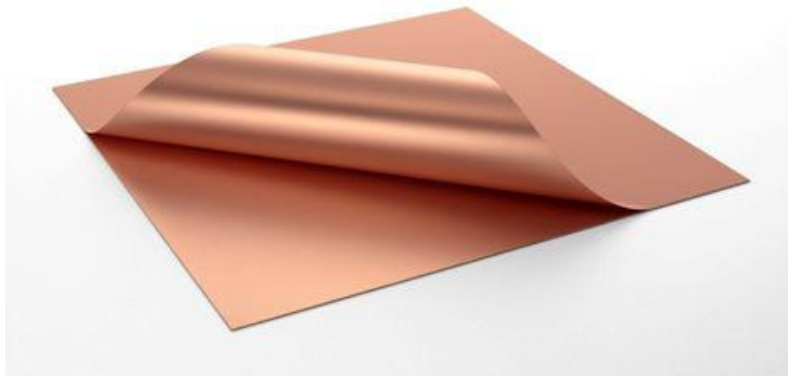
【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL : 03-5437-8028

Eメール : PR@mitsui-kinzoku.com

「MicroThin™」写真



上部 : キャリア銅箔 (厚み 18 μ m、12 μ m)

下部 : 極薄銅箔 (厚み 1.5 μ m~5 μ m)